

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED
上海先進半導體製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：03355)

2009年中期業績初步公告
截至2009年6月30日止6個月

中期業績

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)將截至2009年6月30日止6個月的未經審核中期業績公佈如下：

中期損益表

截至2009年6月30日止6個月

	附註	截至2009年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2009年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
營業額	5	178,466	295,799	260,584	518,892
銷售成本		(135,989)	(303,815)	(255,697)	(502,840)
毛利／(負毛利)		42,477	(8,016)	4,887	16,052
銷售及市場推廣開支		(1,602)	(2,688)	(2,061)	(3,248)
行政開支		(9,826)	(20,635)	(18,221)	(38,024)
研發成本		(10,898)	(20,180)	(2,021)	(8,800)
經營業務利潤／(虧損)		20,151	(51,519)	(17,416)	(34,020)
其它收入	6	398	2,704	45,325	48,427
其它費用	6	(308)	(2,519)	(3,497)	(10,590)
融資成本	7	(2,368)	(4,875)	(4,522)	(10,391)
除所得稅前之溢利／(虧損)	7	17,873	(56,209)	19,890	(6,574)
所得稅退款	8	—	92	—	—
本公司普通股股東 應佔淨溢利／(虧損)		17,873	(56,117)	19,890	(6,574)
股息	9	—	—	—	—
本公司普通股股東 每股盈利／(虧損)					
— 基本	10	1.16分	(3.66)分	1.30分	(0.43)分

中期財務狀況表

2009年6月30日

		2009年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2008年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		500,580	579,405
在建工程		8,562	731
土地租賃預付款		33,928	34,316
無形資產		8,765	10,687
非流動資產總值		<u>551,835</u>	<u>625,139</u>
流動資產			
存貨		110,851	156,220
應收貿易賬款及應收票據	11	72,583	41,168
預付款項、按金及其它應收款項		7,770	16,358
其他金融資產		—	10,000
應收關聯公司款項		13,650	28,442
現金及現金等價物		265,636	261,887
流動資產總值		<u>470,490</u>	<u>514,075</u>
資產總值		<u>1,022,325</u>	<u>1,139,214</u>
流動負債			
應付貿易賬款	12	79,977	122,108
應計負債及其它應付款項		39,128	47,519
應付關聯公司款項		43,577	43,456
計息借款		178,319	188,598
流動負債總值		<u>341,001</u>	<u>401,681</u>
流動資產淨值		<u>129,489</u>	<u>112,394</u>
非流動負債			
遞延稅負債		—	92
資產淨值		<u>681,324</u>	<u>737,441</u>
股本及儲備			
註冊及繳足股本		1,534,227	1,534,227
儲備		(852,903)	(796,786)
股東權益		<u>681,324</u>	<u>737,441</u>

中期權益變動表

截至2009年6月30日止6個月

	截至2009年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
註冊及繳足股本 普通股每股面值人民幣1.00元 期初及期末餘額	1,534,227	1,534,227
資本儲備 期初及期末餘額	205,363	205,363
法定盈餘公積 期初餘額和期末餘額	19,353	19,353
累計虧損 期初餘額	(1,021,502)	(784,419)
本期虧損	(56,117)	(6,574)
期末餘額	(1,077,619)	(790,993)
儲備	(852,903)	(566,277)
股東權益	681,324	967,950

中期簡明現金流量表
截至2009年6月30日止6個月

	截至2009年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
經營業務現金流入淨額	15,440	109,881
投資活動現金流出淨額	(1,412)	(5,939)
融資活動現金流出淨額	(10,279)	(81,140)
現金及現金等價物增加淨額	3,749	22,802
現金及現金等價物之期初餘額	261,887	206,995
現金及現金等價物之期末餘額	265,636	229,797
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行存款	73,434	162,735
未抵押定期存款	192,202	67,062
	265,636	229,797

簡明財務報表附註

1. 公司資料

上海先進半導體製造股份有限公司(以下簡稱「本公司」)為按照中國《外商投資企業法》於1988年10月4日在中國人民共和國(「中國」)成立之外商投資企業，經營期限30年，從1988年10月4日至2019年10月3日。

於2004年3月2日，本公司通過發行1,109,080,000股每股價值為人民幣1.00元繳足之股本重新註冊為外商投資股份有限公司，經營期限改為無限期。於2006年4月7日，本公司的H股在香港聯合交易所有限公司成功上市。

本公司的註冊所在地及主要經營地位於中國上海虹漕路385號(郵編200233)。

本公司主要從事5寸、6寸和8寸晶圓的生產製造和銷售。

2. 呈報基準

本公司截至2009年6月30日止6個月未經審核中期簡明財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六之適用披露要求以及國際會計準則理事會頒佈之國際會計準則第34號《中期財務報告》編製。

本公司按持續經營原則編製本未經審核中期簡明財務報表，因為本公司認為有足夠經營產生的現金流入以及可使用的銀行信用額度，令本公司自2009年6月30日後不少於12個月的期間內將有能力在債務到期時履行財務上的償付責任。

本未經審核中期簡明財務報表須與本公司於2009年3月25日發佈的截至2008年12月31日止年度的經審核財務報告（「2008年度財務報告」）一併進行閱讀。

3. 重大會計政策

本未經審核中期簡明財務報表已根據國際財務報告準則編製的要求編製。

除未採納如下2009年1月1日新發佈之國際財務報告準則及詮釋外，本公司在編製本未經審核中期簡明財務報表所採納的會計政策與本公司2008年度財務報告所採納者一致。

新發佈及經修訂之國際財務報告準則之影響

對於本未經審核中期簡明財務報表，本公司已初次採納下述新發佈之國際財務報告準則之詮釋及修訂本。

國際會計準則第1號（經修訂）財務報表之列報

國際會計準則第32及1號（修訂本）可沽售財務工具及清盤時產生之承擔

國際財務報告準則第2號（修訂本）以股權為基礎的付款－歸屬條件及註銷

國際財務報告準則第8號經營分部

國際會計準則第23號（經修訂）借貸成本

修訂國際財務報告準則第7號金融工具：披露－改善金融工具披露

國際財務報告詮釋委員會詮釋第13號客戶忠誠計劃

國際財務報告詮釋委員會詮釋第15號有關興建房地產之協議

國際財務報告詮釋委員會詮釋第16號對境外業務淨投資之對沖

除國際財務報告準則第1號（經修訂）對披露有影響外，採納該等新發佈之國際財務報告準則之詮釋及修訂本對本未經審核中期簡明財務報表並無重大影響。

新發佈但還未生效之國際財務報告準則之影響

本公司尚未於本未經審核中期簡明財務報表中應用以下已頒佈但還未生效的新發佈或經修訂的國際財務報告準則。

修訂國際財務報告詮釋委員會第9號及國際會計準則第39號－嵌入式衍生工具¹

國際財務報告準則第3號（經修訂）業務合併²

國際會計準則第27號（經修訂）綜合及單獨財務報表²

國際財務報告詮釋委員會詮釋第17號向擁有人分派非現金資產²

國際財務報告詮釋委員會詮釋第18號自客戶轉撥資產²

¹ 對2009年6月30日或之後結束之年度期間生效

² 對2009年7月1日或之後開始之年度期間生效

本公司董事預期採用這些國際財務報告準則不會對本公司的經營結果以及財務狀況產生重大影響。

4. 分類資料

本公司之營業額及溢利主要來自晶圓銷售。本公司僅有一個業務類別。

本公司主要資產位於中國上海，因此，並未對本公司資產地理位置提供分類數據。

本公司營業額乃按客戶所在地進行地理分區。基於客戶所在地之營業額地區分類資料列示如下：

	截至2009年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2009年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
美國	93,921	178,126	136,019	250,483
歐洲	37,459	54,805	69,673	163,779
亞洲	47,086	62,868	54,892	104,630
	178,466	295,799	260,584	518,892
5. 營業額				
	截至2009年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2009年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
營業額				
貨物銷售	178,367	295,634	260,498	518,776
其它	99	165	86	116
	178,466	295,799	260,584	518,892
6. 其它收入和其它費用				
	截至2009年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2009年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
其它收入				
停電損失保險賠償	—	—	43,500	43,500
補貼收入	—	2,000	—	—
利息收入	397	703	7	2,089
利率掉期收益	—	—	826	(415)
淨匯兌收益	—	—	(284)	384
其他	1	1	1,276	2,869
	398	2,704	45,325	48,427
其它費用				
停電損失	—	—	(2,997)	(10,090)
捐贈	—	—	(500)	(500)
利率掉期損失	(60)	(156)	—	—
淨匯兌損失	(68)	(1,542)	—	—
其他	(180)	(821)	—	—
	(308)	(2,519)	(3,497)	(10,590)

7. 除所得稅前之溢利／(虧損)

除所得稅前之溢利／(虧損)已扣除／(貸計)下列各項：

	截至2009年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2009年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
存貨銷售成本	135,989	303,815	255,697	502,840
銀行貸款利息	2,368	4,875	4,522	10,391
折舊	40,469	82,412	56,679	113,999
存貨跌價準備轉回	(14,704)	(21,688)	(848)	(5,627)
壞帳準備計提／(轉回)	550	(1,217)	—	—
處置物業、廠房及設備(收益)／損失	(6)	(6)	191	595

8. 稅項

由於本公司截至2008年、2009年6月30日止3個月及6個月並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出準備。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》，法定公司稅率統一為25%。由於本公司被評為「高新技術企業」，因此自2008年1月1日至2010年12月31日，本公司享受15%的稅率。由於本公司截至2008年、2009年6月30日止3個月及6個月仍為虧損，因此並無就中國企業所得稅作出準備。

所得稅淨額主要構成如下：

	截至2009年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2009年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
本期就溢利所作出之所得稅準備	—	—	—	—
遞延稅項	—	92	—	—
所得稅	—	92	—	—

9. 股息

董事會建議不派發截至2009年6月30日止6個月中期股息(截至2008年6月30日止6個月：無)。

10. 普通股股東每股盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損)乃按本公司普通股股東應佔淨盈利／(虧損)除以於相應期間內加權平均發行在外之股數計算。

	截至2009年 6月30日止 3個月 (未審數)	截至2009年 6月30日止 6個月 (未審數)	截至2008年 6月30日止 3個月 (未審數)	截至2008年 6月30日止 6個月 (未審數)
普通股股東盈利／(虧損) (人民幣千元)	<u>17,873</u>	<u>(56,117)</u>	<u>19,890</u>	<u>(6,574)</u>
加權平均普通股股本 (千股)	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>

於相應期間內無導致每股盈利／(虧損)攤薄之事項存在，故經攤薄之每股盈利／(虧損)未作披露。

11. 應收貿易賬款及應收票據

	2009年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2008年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
應收賬款	<u>80,422</u>	<u>44,859</u>
應收票據	<u>—</u>	<u>5,365</u>
	<u>80,422</u>	<u>50,224</u>
應收賬款減值準備	<u>(7,839)</u>	<u>(9,056)</u>
	<u>72,583</u>	<u>41,168</u>

本公司提供給客戶的信用期限一般為30天到60天。

於2009年6月30日的應收貿易賬款及應收票據按發票日計算的賬齡分析如下：

	2009年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2008年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
30天內	<u>42,729</u>	<u>38,615</u>
31天至90天	<u>28,710</u>	<u>408</u>
91天至180天	<u>612</u>	<u>1,919</u>
181天至365天	<u>450</u>	<u>226</u>
超過365天	<u>82</u>	<u>—</u>
	<u>72,583</u>	<u>41,168</u>

應收帳款減值準備的變動分析如下：

	2009年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2008年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
年初餘額	9,056	—
確認之減值損失	—	9,056
轉回之減值損失	(1,217)	—
期末／年末餘額	7,839	9,056

2009年6月30日到期但未減值的應收貿易賬款帳齡分析如下：

	已到期但未減值					
	合計 人民幣千元	既未到期又 未減值				
		<60天 人民幣千元	60-180天 人民幣千元	181-365天 人民幣千元	>365天 人民幣千元	
2009年6月30日	72,583	32,739	38,985	631	146	82
2008年12月31日	41,168	35,216	3,699	2,253	—	—

本公司應收貿易賬款及應收票據的賬面金額約相當於公允價值。

12. 應付貿易賬款

於2009年6月30日的應付貿易帳款按發票日計算的帳齡分析如下：

	2009年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2008年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
30天內	70,725	101,868
31天至90天	3,950	13,245
91天至180天	2,082	3,278
181天至365天	769	1,302
超過365天	2,451	2,415
	79,977	122,108

本公司應付貿易賬款的賬面金額約相當於公允價值。

管理層討論及分析

截至2009年6月30日止6個月與截至2008年6月30日止6個月的比較

銷售額

截至2009年6月30日止6個月期間，本公司經營遭遇了全球經濟衰退而引起客戶需求大幅度下降的影響。因此，截至2009年6月30日止6個月的本公司銷售額為人民幣2.958億元，較截至2008年6月30日止6個月的銷售額人民幣5.189億元下降43.0%。在報告期內，本公司8英寸等值晶圓的交付量較截至2008年6月30日止6個月的210,597片減少35.4%至135,965片。

銷售成本及毛利

截至2009年6月30日止6個月的本公司毛利虧損達人民幣800萬元，毛利率為負2.7%，截至2008年6月30日止6個月的毛利為人民幣1,610萬元，毛利率為3.1%，毛利率下降主要源於特別低水平的產能利用率和因宏觀經濟惡化造成較低平均銷售價格，且部分為成本降低舉措及截至2008年12月31日之財務年度實施了8英寸晶圓資產減值致使報告期內的折舊費用降低人民幣2,140萬元即反映在銷售成本減少人民幣1,880萬元所抵消。

經營費用及經營收益

截至2009年6月30日止6個月銷售及市場推廣開支由截至2008年6月30日止6個月的人民幣320萬元下降至人民幣270萬元，主要源於薪資相關費用支出減少和因總體銷售額減少致使銷售佣金率下降。

截至2009年6月30日止6個月行政開支為人民幣2,060萬元，與截至2008年6月30日止6個月的行政開支人民幣3,800萬比較，降幅為45.8%，主要歸因於歷年福利費沖減致使薪資相關費用減少和較低保險費及外包服務費用。

截至2009年6月30日止6個月研發成本為人民幣2,020萬元，與截至2008年6月30日止6個月的研發成本人民幣880萬元相比，上升129.5%，主要因報告期內研發活動增加及工程晶圓出售減少致使相關研發費用上升。

因此，本公司截至2009年6月30日止6個月的經營業務虧損為人民幣5,150萬元，截至2008年6月30日止6個月的經營業務虧損為人民幣3,400萬元。本公司截至2009年6月30日止6個月的經營毛利率為負17.4%，截至2008年6月30日止6個月的經營毛利率為負6.6%。

其他開支、其他收入及融資成本

截至2009年6月30日止6個月其他開支為人民幣250萬元，去年同期的其他開支為人民幣1,060萬元。2009年上半年，本公司的其他開支主要由利率掉期虧損和淨匯兌損失及其他組成。去年同期的其他開支主要由停電造成費用和捐贈組成。

本公司截至2009年6月30日止6個月的其他收入為人民幣270萬元，去年同期的其他收入為人民幣4,880萬元。2009年上半年，本公司的其他收入主要源於補貼收入和利息收入。而2008年上半年的其他收入主要源於人民幣4,350萬元停電保險賠償、利息收入和淨匯兌收益及其他收益。

本公司截至2009年6月30日止6個月的融資成本為人民幣490萬元，較截至2008年6月30日止6個月的融資成本人民幣1,040萬元下降52.9%，主要為本公司銀行貸款餘額降低導致利息支出減少。

淨利潤

綜上所述，本公司截至2009年6月30日止6個月的淨虧損為人民幣5,610萬元，截至2008年6月30日止6個月的淨虧損為人民幣660萬元。

流動資金及資金來源

於2009年6月30日及2008年12月31日，本公司的現金及現金等價物分別為人民幣2.656億元和人民幣2.619億元。截至2009年6月30日止，本公司的經營業務之現金流入淨額為人民幣1,540萬元，截至2008年6月30日止的經營業務之現金流入淨額人民幣1.099億元。

本公司的投資活動現金流出淨額主要用於對物業、廠房、設備以及在建工程的持續投資。截至2009年6月30日，本公司的資本開支淨額為人民幣1,140萬元。去年同期的資本開支淨額為人民幣590萬元。報告期內大部分資本開支用於提高和改善5英寸和6英寸晶圓設施的靈活性和運行效率。

截至2009年6月30日止6個月本公司的融資活動現金流出淨額為人民幣1,030萬元，截至2008年6月30日止6個月本公司的融資活動現金流出淨額為人民幣8,110萬元。前者主要是在報告期內由於償還銀行貸款人民幣3,760萬元和新增銀行貸款人民幣2,730萬元。在今年上半年及去年同期，本公司僅依托銀行貸款來從事經營活動。

於2009年6月30日，本公司短期付息借款餘額為人民幣1.783億元，在這短期付息借款中，約62%為人民幣及剩餘38%為美元。

截至2009年6月30日止，本公司的流動比率為1.38，截至2008年12月31日止為1.28。本公司的總負債與股東權益之比由2008年12月31日止的54.5%改善至2009年6月30日之50.0%。

員工

截至2009年6月30日止，本公司聘用1,199名員工，與截至2008年12月31日止的1,269員工相比，員工數下降5.5%。本公司在報告期內與其員工維持著良好工作關係並按照中國相關法規和政策為員工提供和支付報酬和福利。

利率風險

截至2009年6月30日止，本公司所有借款全部是一年期固定利率的流動資金貸款。本公司對本金630萬美元應付利息訂立利率掉期，以對沖利率波動風險。

人民幣波動風險

由於人民幣是本公司的功能性和申報貨幣為人民幣。現本公司收入和支出中有一大部分是外幣。如果本公司的人民幣收入不足以支付人民幣支出，則需要將外幣轉換為人民幣來彌補差額，在轉換中可能引起匯兌虧損，直至導致對本公司現金流量產生負面影響。在報告期內，本公司未運用金融衍生工具規避人民幣升值。

資本承諾

截至2009年6月30日止，本公司購買物業、廠房、設備的資本承諾為人民幣1,310萬元，其中人民幣1,110萬元為已訂約但未撥備，剩餘的人民幣200萬元為已授權但未訂約。

2009年第二季度業績回顧

2009年第二季度銷售額為人民幣1.785億元，相比2009年第一季度銷售額人民幣1.173億元，環比增加52.2%，主要歸因於6英寸和8英寸晶圓銷售大幅增加，及5英寸晶圓銷售有較小程度的增加。

2009年第二季度毛利為人民幣4,250萬元，2009年第一季度毛利虧損為人民幣5,050萬元。2009年第二季度毛利率達到23.8%，而2009年第一季度毛利率為負43.1%，主要源於每片晶圓單位成本下降致使過往幾個月計提庫存沖回和浪費產能庫存量調整減少共計達人民幣2,330萬元及晶圓廠產能利用率提高。

2009年第二季度營業開支為人民幣2,230萬元，較2009年第一季度營業開支人民幣2,120萬元上升5.2%，主要歸因於研發費用及市場推廣開支上升，且部分為行政開支下降所抵消。

2009年第二季度其他收入和融資成本為人民幣負200萬元，2009年第一季度其他收入和融資成本為人民幣負20萬元，主要源於較低其他收入。2009年第二季度其他收入主要包含利息收入。2009年第一季度其他收入主要包含補貼收入和利息收入。

截至2009年6月30日止之3個月其他開支為人民幣30萬元，截至2009年3月31日止之3個月其他開支為人民幣220萬元。本季度的其他開支減少主要歸因於淨匯兌損失及其他之大幅度下降，及利率掉期損失有較小程度下降。

因此，2009年第二季度淨利潤為人民幣1,790萬元，2009年第一季度淨虧損為人民幣7,400萬元。

1. 營業額分析

用途

2009年第二季度本公司在通訊，電腦，消費品方面的營業額分別佔總收入的33%，33%和34%，與第一季度基本持平。

	09第二季度	09第一季度	08第二季度
通訊	33%	32%	32%
電腦	33%	33%	32%
消費品	34%	35%	36%

地區

2009年第二季度本公司在美國、歐洲和亞太地區的銷售佔總收入分別為53%、26%和21%，而上季度則分別為72%、15%和13%。美國的銷售比例下降主要源於歐洲及亞洲銷售收入大幅增加所致。

	09第二季度	09第一季度	08第二季度
美國	53%	72%	52%
歐洲	26%	15%	27%
亞太地區	21%	13%	21%

客戶類型

2009年第二季度集成器件製造商和無生產綫半導體公司的銷售佔總收入分別為26%和74%，上季度分別為24%和76%。

	09第二季度	09第一季度	08第二季度
集成器件製造商	26%	24%	37%
無生產綫半導體公司	74%	76%	63%

產品

5英寸、6英寸和8英寸於2009年第二季度銷售佔總收入分別為20%、39%和40%，上季度分別為20%、37%和41%。

	09第二季度	09第一季度	08第二季度
5英寸晶圓	20%	20%	18%
6英寸晶圓	39%	37%	50%
8英寸晶圓	40%	41%	31%
其他 ¹	1%	2%	1%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
總計	100%	100%	100%

備註1：包括測試服務及掩膜提供

2 · 利用率和產能(8英寸等值晶圓)

2.1 利用率

2009年第二季度總體產能利用率為49%，2008年第二季度為66%，主要因市場環境疲軟致使實際掩膜銷售大幅度下降，但與2009年第一季度的33%相比有提高。

晶圓製造廠	09第二季度	09第一季度	08第二季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	55%	33%	64%
6英寸晶圓	40%	24%	74%
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	56%	43%	57%
總體產能利用率	49%	33%	66%

備註： 產能利用率指報告期內由裝運的半導體晶圓加工程序實際數(以掩膜層數計算)除以晶圓製造廠可在相應期間內提供加工程序數百分比。

2.2 產能(8英寸等值晶圓)

2009年第二季度生產8英寸等值晶圓的產能為154千片，與2009年第一季度和2008年第二季度相同。

晶圓製造廠(千片晶圓)	09第二季度	09第一季度	08第二季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	33	33	33
6英寸晶圓	85	85	85
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	36	36	36
總體產能	154	154	154

備註： 5英寸、6英寸和8英寸的產能分別以每片晶圓9、10和22Mask層數估算。5、6英寸晶圓需將晶圓片除以2.56和1.78，以換算成8英寸等值晶圓。

3 · 應收賬款／存貨周轉率

2009年第二季度應收賬款及票據周轉天數為35天，上季度42天。

2009年第二季度存貨周轉天數為97天，上季度為96天。

	09第二季度	09第一季度	08第二季度
應收賬款及票據周轉率(天數)	35	42	43
存貨周轉率(天數)	97	96	67

4 · 資本支出

2009年第二季度資本支出為人民幣730萬元，第一季度為人民幣410萬元。

	09第二季度	09第一季度	08第二季度
(金額：人民幣千元)			
資本支出	7,331	4,087	5,546

前景及未來計劃

全球半導體產業已在今年第一季度到達周期性穀底，雖然要達到完全恢復也許是個長期和緩慢的進程，但有望看到日後逐步改善。此外，鑒於特定的地理區域及持續宏觀經濟疲軟情況，許多供應鏈的參與者仍然將庫存控制在相對較低水平，再加之需求緩慢改善前景和典型的年底季節性市場放緩。因此，本公司的短期業務前景仍面臨挑戰。

近年來，在政府倡導發展中國汽車電子芯片產業鼓舞之下，本公司已採取措施引進質量保證體系並運用策略合作夥伴之一的工藝技術來支持汽車電子業務。本公司非常榮幸於近期已為政府列入迄今為止唯一候選企業建立汽車電子芯片產業化製造平台，該平台預計在本公司中長期發展規劃中發揮重要作用。未來，本公司計劃與產業鏈上具有領先地位的從業者合作以開發自主知識產權，從而使本公司成為中國首家汽車電子芯片製造晶圓廠。

此外，為應對當前的經濟環境，本公司未來將透過進一步落實降低成本措施，優化內部資源，提供優質客戶服務及大力開拓新市場來繼續提高經營業績。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2009年6月30日止6個月，本公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

董事、監事和最高行政人員的權益及淡倉

於2009年6月30日，(a)根據證券及期貨條例第352條所存置的登記冊顯示，或(b)按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)中，必須知會本公司及聯交所的規定，沒有董事、監事和最高行政人員於本公司及其相關法人(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有權益或淡倉。

主要股東的權益及淡倉

於2009年6月30日，根據證券及期貨條例第336條所存置的主要股東登記名冊顯示，下列股東(非本公司董事、監事或最高行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有的權益或淡倉。

股東名稱	股份類別	股份數目	身份	佔該類別 已發行股份	佔已發行 總股本
恩智浦有限公司	H股	408,806,888 (長倉)	實益擁有人	36.13%	26.65%
恩智浦有限公司	非上市 外資股	12,643,512 (長倉)	實益擁有人	100%	0.82%
上海化學工業區 發展有限公司	H股	254,866,584 (長倉) (附註1)	實益擁有人	22.53%	16.61%
中國東方資產管理公司	內資股	179,303,000 (長倉)	實益擁有人	45.95%	11.69%
上海化學工業區 發展有限公司	內資股	122,220,616 (長倉) (附註2)	實益擁有人	31.32%	7.97%
上海貝嶺股份有限公司	內資股	88,726,400 (長倉)	實益擁有人	22.74%	5.78%

附註：

1. 所有該等254,866,584 H股(長倉)被視為透過上海化學工業區投資實業有限公司和上海化學工業區(香港)有限公司間接持有的公司權益。
2. 所有該等122,220,616內資股(長倉)被視為透過上海化學工業區投資實業有限公司間接持有的公司權益。

購股權計劃

於2009年6月30日，本公司沒有上市規則第17章所定義之購股權計劃。

企業管治

遵守企業管治常規守則(「管治守則」)

本公司承諾維持高水平的企業管治，以便確保提高透明度以及對股東利益的保護。於截至2009年6月30日止6個月期間內，本公司完全遵守上市規則附錄14載列的管治守則。

標準守則

本公司已採納標準守則作為公司董事和監事進行證券交易的行為守則。

本公司經向所有董事和監事作出具體查詢後，確認所有董事和監事於截至2009年6月30日止6個月期間內，均已遵守標準守則所規定的標準。

經審計委員會審閱

本公司審計委員會包括三位獨立非執行董事，James Arthur Watkins先生(主席)、Thaddeus Thomas Beczak先生和沈偉家先生，以及兩位非執行董事，Christopher Paul Belden先生和諸培毅先生。本公司截至2009年6月30日止6個月期間的中期業績未經審核，但已經由審計委員會及本公司的外部審計師安永會計師事務所審閱。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
執行董事、總裁及首席執行長
周衛平
執行董事及首席財務長
程堅玉

中國上海，2009年8月18日

於本業績公告公佈日期，本公司以周衛平和程堅玉為執行董事；以陳建明、諸培毅、朱健、李智、葉昱良及Christopher Paul Belden為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及James Arthur Watkins為獨立非執行董事。